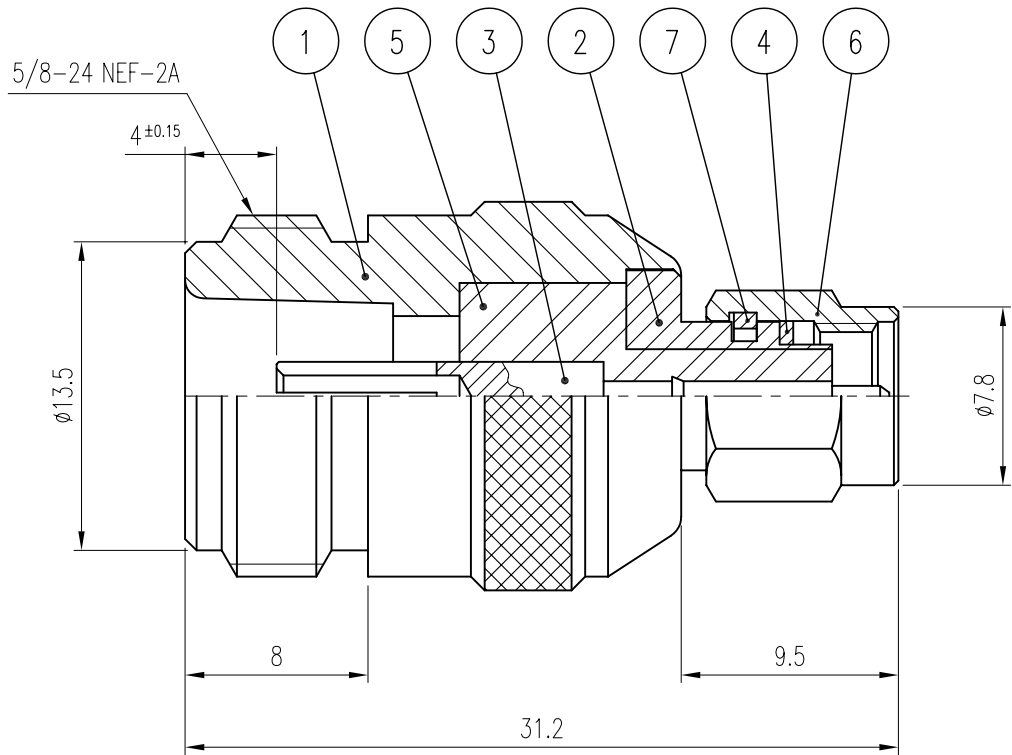


기공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										1	[설변No.연구2006-004] BODY B조립시 가시머루 면취가 적어서 돌아가는 현상 방지 치수변경 C0.3->C0.5	김안철	최종락	2006. 1. 4.	
ST(개선)															



7	SPRING RING	1	PBW	Gold Plate	DSR00002-N5/1 (R2001)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-135/1 (K2001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00021-N/1 (HA064)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00004-N/1 (G2001)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DAC00033-1345/1 (EA049)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00260-135/1 (DA121)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00919-135/1 (DA053)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1999. 8. 20.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. SMAP-NJ		
	승인						
	검도						
재질	재도				도명		
열처리	작성부서						
보호피막처리	연 구 소			A4	도번 AD00015-7/1 K361-711-000		
	척도 3/1	단위 mm	중량				